

千住金属工業

千住金属工業は、はんだ材料、FA装置メーカーである強みを生かし、情報共有とシナジー効果によ

た接合部からのボイドをなくすことに成功した製品を紹介する。同社は各種ソリューションを提供しており、展示会では「電装・カーエレソリ」を防止するやに入りはんだM705、電装/カーエレ用途には最適なはんだ合金M53、残渣が割れず

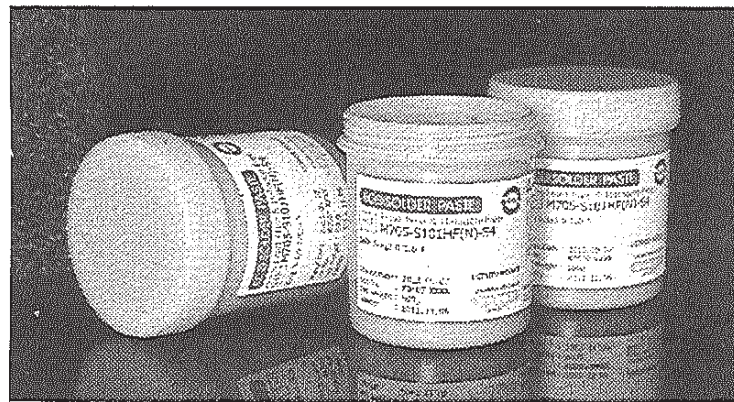
電装・カーエレと3Dパッケージとソリューションを紹介

り、新たなソリューションを提供している。

今回の展示会では、フラックスに熱酸化材料を使い自社のFA装置による最適なプロファイルで、ソルダ

ンを提供しており、展示会では「電装・カーエレソリ」を防止するやに入りはんだM705、電装/カーエレ用途には最適なはんだ合金M53、残渣が割れず

ボールを含有させたソルダース、Cu-OSP基板でもボイドを激減したM705、NX001、電装/カーエレ用途には最適なはんだ合金M53、残渣が割れず



千住金属工業のエコソルダーペーストM705

性ど耐落下衝撃性を両立させたソルダーボールM770、POP実装用転写ソルダーペーストNSV320を紹介する。

ブースには、はんだ付け体験コーナーも併設しており、こて先食われを防止するやに入りはんだを紹介する。また、30分間隔で注目の新製品合NW0不良を解決するS101-S4HF、耐熱

ペーストでは困難であった

パワー半導体実装にNi

BGA接合での新たな不具

合NW0不良を解決するS101-S4HF、耐熱

耐熱